

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制対象施設

1 大気基準適用施設（施行令別表第1）及び排出基準

（単位：ng-TEQ / Nm³、ngは10億分の1g）

特定施設の種類		排出基準		
1	焼結炉（鉄鉄製造）の製造用焼結炉 [原料処理能力1トン/時以上]	新設	0.1	
		既設	1	
2	製鋼用電気炉（鋳鉄、鍛鋼用は除く） [変圧器の定格容量1000kVA以上]	新設	0.5	
		既設	5	
3	亜鉛回収用焙焼炉、焼結炉等 [原料処理能力0.5トン/時以上]	新設	1	
		既設	10	
4	アルミニウム合金製造用焙焼炉等 [原料処理能力0.5トン/時以上、 溶解炉は容量1トン以上]	新設	1	
		既設	5	
5	廃棄物焼却炉 [火床面積が0.5m ² 以上又は 焼却能力が50kg/時間以上]	4トン/時以上	新設	0.1
		4トン/時未満 2トン/時以上	既設	1
			新設	1
		2トン/時未満 200kg/時以上 (又は火格子面積が 2m ² 以上)	既設	5
			新設	5
		200kg/時未満 50kg/時以上 (又は火床面積が 0.5m ² 以上)	既設	10
			新設	5
		既設	10	

注1 平成12年1月15日以降に設置された施設については、新設の基準が適用される。

2 平成12年1月14日以前に設置された施設については、既設の基準が適用される。

3 製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉（印部分）について、既設は平成9年12月1日以前、新設は平成9年12月2日以降に設置された施設について適用される。

2 排水規制の特定施設（施行令別表第2）及び排出基準

（単位：pg-TEQ / リットル、pgは1兆分の1グラム）

特定施設の種類		排出基準
1	硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）製造用の塩素、塩素化合物による漂白施設	10
2	カーバイド法アセチレン製造施設のアセチレン洗浄施設	
3	硫酸カリウム製造施設の廃ガス洗浄施設	
4	アルミナ繊維製造施設の廃ガス洗浄施設	
5	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設の廃ガス洗浄施設	
6	塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設	
7	カプロラクタムの製造施設（塩化ニトロシルを使用するもの）の硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設の水洗施設、廃ガス洗浄施設	
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造施設のろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設	
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造施設のろ過施設、廃ガス洗浄施設	
11	ジオキサジンバイオレット製造施設のニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金製造施設の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
13	亜鉛回収施設の精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
14	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法によるものを除く。）の用に供する施設のろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設	
15	廃棄物焼却炉（火床面積0.5m ² 以上又は焼却能力50kg / h以上）の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設（汚水を排出するもの）	
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設	
17	フロン類（の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
18	下水道終末処理施設（1～17及び19の施設の汚水等を含む下水を処理するもの）	
19	1～17号の施設を設置する事業場からの排水（当該汚水等を含むもので、公共用水域に排出されるものを除く）の処理施設（18号を除く）	